



電子情報技術産業協会規格

Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

JEITA ED-7618

半 導 体 包 装 用 語 集

Terms and definitions for semiconductor packing

2017 年 5 月制定

作 成

半導体パッケージング技術委員会

Semiconductor Packaging Technical Committee

発 行

一般社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

まえがき

この規格は、一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）標準化センター 半導体パッケージング技術委員会 半導体包装サブコミティが作成したものである。

この規格は、国際規格に整合するために制定された次の規格に基づいて、**JEITA TSC-16**（電子情報技術産業協会規格類の作成基準）の様式によって作成した規格である。

この規格は、著作権法によって保護されている著作物であるため、許可なくこの規格の一部又はすべてを複製・転載することを禁止する。

この規格は、その一部が工業所有権（特許権，実用新案権，意匠権など）に抵触する可能性に関係なく，作成されている。一般社団法人 電子情報技術産業協会は，このような工業所有権に係る確認について，責任はもたない。

電子情報技術産業協会規格

半 導 体 包 装 用 語 集

Terms and definitions for semiconductor packing

1 適用範囲

この規格は、半導体包装に関する用語（以下、用語という。）の意味について規定する。

2 引用規格及び文書

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発行年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版、Amendment 又は追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は、その最新版（Amendment・追補を含む）を適用する。

関連規格

トレイ規格	: JEITA ED-7617	マトリクストレイデザインガイド
エンボス規格	: JEITA ET-7200C	自動実装用部品のテーピングに用いるリユースリール
	JEITA ETR-7026	自動実装用部品の容器包装用語
	JIS C 0806-3	自動実装部品の包装—第3部：表面実装部品の連続テープによる包装

3 用語及び定義

用語及び定義は、次のとおりとする。

3.1

トレイ

表面実装部品（SMD：surface mount device）を収納するパレット状の容器

3.2

チップトレイ

ウェーハチップなどの部品を収納するパレット状の容器

3.3

エンボステープ

半導体製品を収納するテープ状の容器

3.4

マガジン

半導体製品を収納する筒状の容器

3.5

包装資材

半導体製品を湿気の影響から保護する目的で防湿性の優れた包装材料

4 備考

- 用語が長い場合は2行にて示す。
- 照合文字の記号は図中の寸法記号を示す。
- 図・部位及び記号欄が「—」のときは対応なきを示す。
- 表中の番号及び図・部位の番号は、図からも表からも用語が分かるように付与した。